भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2307

जिसका उत्तर 7 अगस्त, 2026 को दिया जाना है ।

16 श्रावण, 1948 (शक)

डिज़ाइन आधारित प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना का कार्यान्वयन

2307. श्री सुखेन्दु शेखर रॉयः

डा. संदीप कुमार पाठकः

श्री सामिक भट्टाचार्यः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिज़ाइन आधारित प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना के शुभारंभ से लेकर आज की तिथि तक प्राप्त, अनुमोदित, अस्वीकृत और विलंबित आवेदनों की वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या मंत्रालय ने डीएलआई योजना के तहत समर्थित स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जा रही बाज़ार तक पहुँच संबंधी चुनौतियों की पहचान की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) डीएलआई से सहायता पाने वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ): <u>सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम:</u>**

वर्ष 2022 में, सरकार ने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण पर आधारित था। स्पष्ट नीतिगत प्रस्तावों और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के निरंतर कार्यान्वयन ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू की गई डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना, सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन करने में कार्यरत घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप और एमएसएमई का समर्थन करती है।

डीएलआई योजना के तहत:

- उन्नत चिप डिजाइन टूल के लिए 105 चिप डिजाइन कंपनियों को मंजूरी दी गई। ईडीए उपकरणों के लिए आवेदन रोलिंग आधार पर आमंत्रित किए जाते हैं और निरंतर प्राप्त और संसाधित किए जाते हैं।
- इनमें से 24 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई। वित्तीय सहायता के लिए कोई आवेदन संसाधित करने के लिए लंबित नहीं है।

डीएलआई योजना के तहत आवेदनों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

संघटक	वित्तीय वर्ष	प्राप्त किए गए आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	जांच के दायरे में शामिल किए गए
वित्तीय समर्थन के लिए आवेदन	2022-23	32	3	4	25
	2023-24	9	8	14	12

	2024-25	74	11	39	36
	2025-26	0	2	34	0
	कुल	115	24	91	0
ईडीए उपकरण समर्थन के लिए अनुप्रयोग	2023-24	15	15	0	0
	2024-25	54	51	3	0
	2025-26	56	33	22	1
	2026-27	19	6	5	9
	कुल	144	105	30	0

<u>सेमीकंडक्टर डिजाइन उद्योग में बाजार की चुनौतियां</u>

सरकारी खरीद में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता प्रदान करने के लिए, मंत्रालय जहाँ उपयुक्त हो, सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 और अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ) के अंतर्गत उत्पादों को अधिसूचित करता है। उदाहरण के लिए- सीसीटीवी/वीडियो निगरानी प्रणालियों की अधिसूचना।

स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जाने वाली अन्य बाजार पहुंच चुनौतियों को समझने के लिए, मंत्रालय नियमित रूप से हितधारक परामर्श, क्रेता-विक्रेता संवाद और वार्षिक सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन के माध्यम से डिजाइन इकोसिस्टम हितधारकों (जैसे स्टार्टअप, वैश्विक कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता, फाउंड्री, पैकेजिंग पार्टनर और वीसी) के साथ जुड़ता है।

स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) डिजाइन पूर्ण होने से वाणिज्यिक स्तर के विनिर्माण तक संक्रमण के लिए आवश्यक सीड कैपिटल और स्केल-अप कैपिटल तक सीमित पहुँच;
(ii) स्वदेशी सेमीकंडक्टर उत्पादों का प्रदर्शन करने और संभावित घरेलू तथा वैश्विक ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के सीमित अवसर; तथा
(iii) वाणिज्यिक नियोजन से पहले उत्पाद योग्यता, प्रमाणन और ग्राहक सत्यापन की आवश्यकता।

मंत्रालय द्वारा किए गए सुगम कार्यों के परिणाम निम्नानुसार हैं:

(i) डीएलआई समर्थित कंपनियों द्वारा डीएलआई योजना के अंतर्गत संवितरित वित्तीय सहायता के चार गुना (4×) से अधिक के उद्यम पूंजी (वीसी) निवेश को बढ़ाना। यह इन कंपनियों की तकनीकी क्षमताओं और वाणिज्यिक क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
विश्व स्तर पर, वीसी व्यावसायिक रूप से सफल उत्पादों में नवाचारों को बढ़ाने के लिए आवश्यक ग्राहक जुड़ाव और व्यवसाय विकास और साझेदारी की सुविधा प्रदान करके स्टार्टअप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(ii) अन्य इकोसिस्टम हितधारकों (अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता, फाउंड्रीज़, पैकेजिंग उद्योग) के साथ डीएलआई- समर्थित कंपनियों के सहयोग और समझौते, जिससे घरेलू और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलाओं में उनके एकीकरण को सुदृढ़ किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप कई फाउंड्री में 25 डिजाइनों का सफल टेपआउट हुआ है।

ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि डीएलआई योजना के तहत सरकार के हस्तक्षेप सेमीकंडक्टर स्टार्टअप के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर रहे हैं।

सेमीकॉन 2.0

पहले चरण के सफल कार्यान्वयन के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 15.07.2026 को 1,27,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम छह रणनीतिक स्तंभों यानी चिप्स का डिजाइन; मशीनें और सामग्री; अधिक फैब्स स्थापित करना; एटीएमपी/ओएसएटी उद्योग को और सुदृढ़ करना; अनुसंधान एवं विकास (अनुसंधान एवं विकास); और प्रतिभा विकास के माध्यम से संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।

यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए बढ़ी हुई पूंजी सहायता प्रदान करता है, स्टार्टअप और एमएसएमई से परे घरेलू कंपनियों को समर्थन का विस्तार करता है, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की भागीदारी को सक्षम बनाता है, जिससे वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण को और सुदृढ़ किया जा सकता है।

******